

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年6月18日(2009.6.18)

【公開番号】特開2006-324665(P2006-324665A)

【公開日】平成18年11月30日(2006.11.30)

【年通号数】公開・登録公報2006-047

【出願番号】特願2006-136747(P2006-136747)

【国際特許分類】

H 01 L 25/10 (2006.01)

H 01 L 25/11 (2006.01)

H 01 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 01 L 25/14 Z

【手続補正書】

【提出日】平成21年5月1日(2009.5.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

オフセット集積回路パッケージオンパッケージ積層システムであって、
ベース基板を設けることと、

コンタクトパッドを前記ベース基板上に形成することと、

第1の集積回路を前記ベース基板上に取付けることと、

ベースパッケージ本体を前記第1の集積回路を囲むように形成することと、

オフセット基板を設けることと、

第2の集積回路を前記オフセット基板上に取付けることと、

前記ベース基板の上面の一部が露出するように、前記オフセット基板を前記ベースパッケージ本体のみの上に置くことを含む、前記オフセット基板を前記コンタクトパッドに結合することとを備える、システム。

【請求項2】

受動構成要素、能動構成要素、またはそれらの組合せを前記ベース基板に取付けることをさらに含む、請求項1に記載のシステム。

【請求項3】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの角にある状態で、前記オフセットパッケージを前記ベース基板に取付けることをさらに含む、請求項1に記載のシステム。

【請求項4】

前記ベースパッケージ本体と前記オフセット基板との間に隙間充填接着剤を与えることをさらに含む、請求項1に記載のシステム。

【請求項5】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの1つの端縁と整列された状態で、前記オフセットパッケージを前記ベース基板上に取付けることをさらに含む、請求項1に記載のシステム。

【請求項6】

オフセット集積回路パッケージオンパッケージ積層システムであって、
ベース基板と、

前記ベース基板上に形成されるコンタクトパッドと、
前記ベース基板上に取付けられる第1の集積回路と、
前記第1の集積回路を囲むように成形されるベースパッケージ本体と、
オフセット基板と、
前記オフセット基板上に取付けられる第2の集積回路と、
前記ベース基板の上面の一部が露出するように、前記ベースパッケージ本体の一部のみの上に置かれる前記オフセット基板を含む、前記コンタクトパッドに結合される前記オフセット基板とを含む、システム。

【請求項7】

前記ベース基板に取付けられる受動構成要素、能動構成要素、またはそれらの組合せをさらに含む、請求項6に記載のシステム。

【請求項8】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの角にある状態で前記ベース基板上に取付けられる前記オフセットパッケージをさらに含む、請求項6に記載のシステム。

【請求項9】

前記ベースパッケージ本体と前記オフセット基板との間に隙間充填接着剤をさらに含む、請求項6に記載のシステム。

【請求項10】

オフセットパッケージがベースモールドキャップの1つの端縁と整列された状態で前記ベース基板上に取付けられる前記オフセットパッケージをさらに含む、請求項6に記載のシステム。